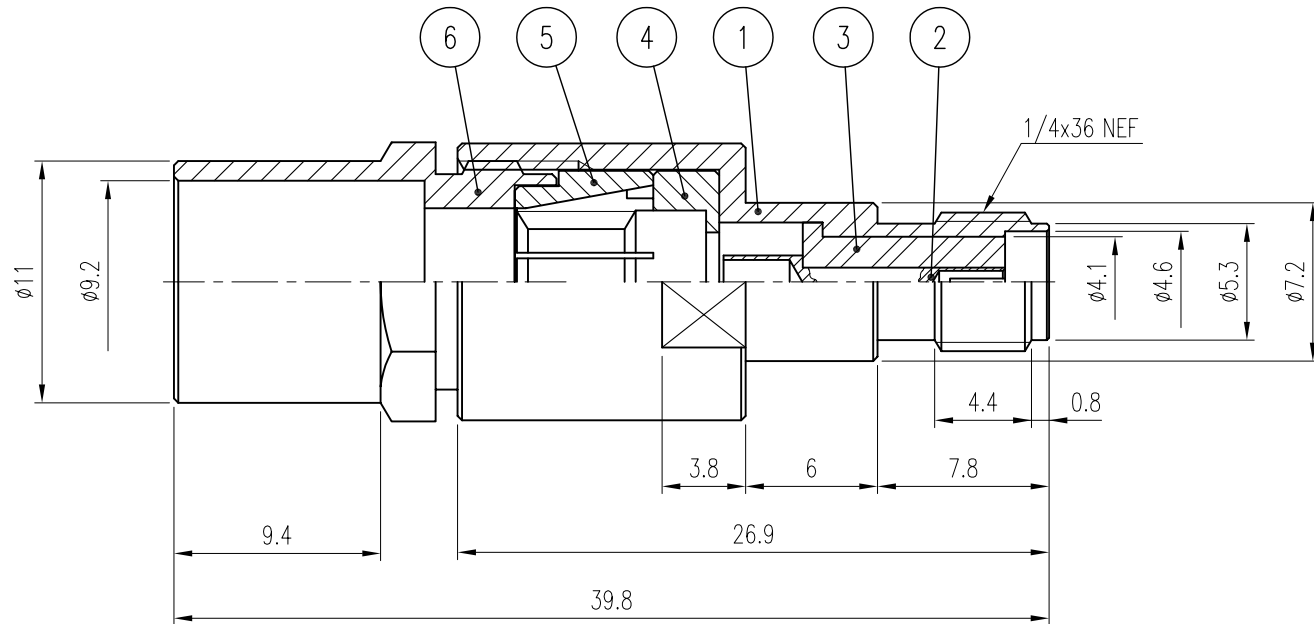


가공 ST											수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)										△					
ST(개선)										△					



6	BACK NUT	1	MBsBD	Gold Plate	DBN00004-135/1 (P2005)
5	BRAID CLAMP	1	MBsBD	Silver Plate	DIS00009-135/1 (M2009)
4	BRAID CLAMP	1	MBsBD	Silver Plate	DIS00008-135/1 (M2008)
3	ISULATOR	1	TEFLON		(H2084)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00135-1345/1 (E2120)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00165-135/1 (D2118)

대체가능재질	품번		품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2001. 2. 15.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.					
	승인							
재질	검도		도명 SJ-PC-1/4					
	재도							
열처리	작성부서		연 구 소				도번 CN00077-7/1	
보호피막처리	적도 5/1							
							K314-211-000	